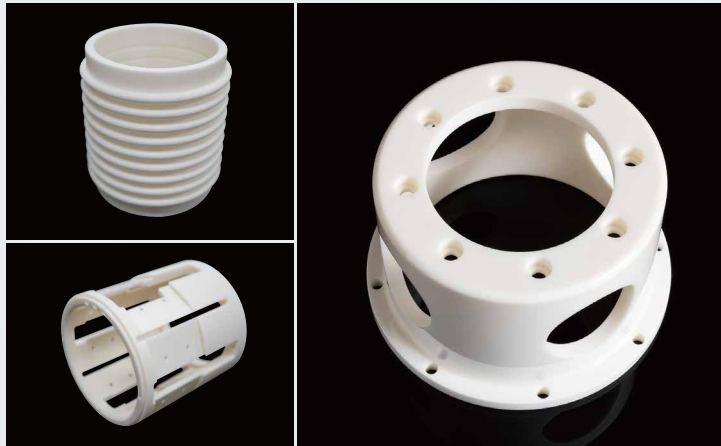


01. Electron Microscopy

[SEM, TEM, FIB]

絶縁碍子

- 真空環境で使用可能
- 5軸加工機による高精度な3次元形状加工が可能
- 最大φ140まで製作可能(内製)
- 沿面距離を稼ぐための波型加工も可能
- ガラスコーティング可能
- 短納期対応も可能



フィードスルー

- 自社内でのMo-Mnメタライズ、ろう付け、溶接までの対応が可能
- 1.0×10^{-11} Pa・m³/s以下を保証
- 高温での高絶縁・形状安定性を確保
- コバルトをメインとし、Mo、Cu-W、Cu、Ni、インバー等の接合実績あり。

※通常は膨張係数の近いコバルトを使用します。



エミッター

- ステム：自社製造のため自由な設計が出来る
- 接合・溶接方法
 - ・セラミックとピン：メタライズろう付けorガラス溶着
 - ・ピンとフィラメント：抵抗溶接
- フィラメント：W、Pt、Ir、Reなど
- 単結晶とブラケットの溶接が可能
- クリーンルーム(クリーンベンチ/クラス1000)での作業が可能

